

## MOS 100 系列MEMS光开关芯片

- ◆ 先进的硅 MEMS 器件
- ◆ 梳齿驱动
- ◆ 高稳定性
- ◆ 大偏转角度
- ◆ 体积小
- ◆ 批量化

性能参数	单位	MOS100	
		最小	最大
镜面直径	mm	1.00	
芯片尺寸	长	3.20	3.25
	宽	1.90	1.95
	厚	0.46	0.48
镜面反射率 (1310~1620nm)	%	95	98
谐振频率	Hz	1000	
X轴偏转角度	Deg	±4	
Y轴偏转角度	Deg	±2	
驱动电压	V		60
工作温度	℃	-5	+75
存储温度	℃	-40	+85
焊盘尺寸	μm <sup>2</sup>	200×200	

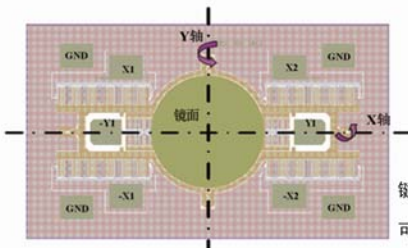
### ● 典型应用

光开关及其阵列是实现光交叉互联和波分复用技术的核心器件，广泛用于光路通断、自动保护倒换、OXC以及OADM等领域。

### ● 备注

1. 测试条件（除非另有说明）：+25℃，+60Vdc。保留对产品手册进行修改且不另行通知的权利。
2. 芯片需在高于万级净化环境中打开包装，并保存于充氮干燥箱中。
3. 打开包装后需尽快完成操作，不宜长时间暴露。
4. 芯片有可动结构，避免用外物触及芯片表面。

### ● 键合说明



键合X1、X2于管座同一引脚，同时键合接地（GND）于管座，可实现镜面X方面偏转，若键合-X1、-X2与GND组合，则可实现反方向偏转；键合Y1或-Y1于引脚，与任一GND组合，可实现镜面Y轴不同方向偏转。